【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年1月21日(2010.1.21)

【公開番号】特開2008-166620(P2008-166620A)
【公開日】平成20年7月17日(2008.7.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-028
【出願番号】特願2006-356731(P2006-356731)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｋ　1/02　(2006.01)
Ｈ０４Ｎ　5/64　(2006.01)
Ｈ０４Ｂ　1/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　1/02　Ｊ
Ｈ０５Ｋ　1/02　Ｎ
Ｈ０５Ｋ　1/02　Ａ
Ｈ０４Ｎ　5/64　５５１Ｚ
Ｈ０４Ｂ　1/08　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月27日(2009.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面に配線層が設けられた配線基板と、
差し込み実装される前記配線基板の一側辺に沿って設けた前記配線層から成る複数の外部接続電極と、
前記配線基板の前記配線層に電気的に接続された回路素子とを具備し、
固定電位が印加される前記外部接続電極を、他の前記外部接続電極よりも面積を大きくすることを特徴とする回路装置。
【請求項２】
前記外部接続電極は、固定電位が印加される前記外部接続電極も含めて、等間隔に離間されることを特徴とする請求項１記載の回路装置。
【請求項３】
前記固定電位は、接地電位または電源電位であることを特徴とする請求項１記載の回路装置。
【請求項４】
前記固定電位が印加される前記外部接続電極の幅は、複数の前記他の外部接続電極の幅と、前記他の外部接続電極が互いに離間する幅とを加算した長さであることを特徴とする請求項１記載の回路装置。
【請求項５】
前記配線基板の第１主面には第１配線層が設けられ、前記配線基板の第２主面には第２配線層が設けられ、
差込実装される領域の前記配線基板の前記第１主面には前記第１配線層から成る第１外部接続電極が設けられ、前記第２主面には前記第２配線層から成る第２外部接続電極が設けられ、

前記第１外部接続電極および前記第２外部接続電極の両方にて、固定電位が印加される前記外部接続電極の面積を、前記他の外部接続電極よりも大きくすることを特徴とする請求項１記載の回路装置。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】回路装置